

Rep. n. 1661/2022

Prot. n. 89854/2022

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTA** la nota del 12.04.2021, a firma del Direttore del Dipartimento di Ingegneria, prof. Andrea Benedetto, e i relativi allegati, nei quali si rappresenta l'esigenza di provvedere all'affidamento della fornitura di una Strumentazione per il packaging avanzato di dispositivi micromeccanici e microelettronici "*HB100 Automatic Wedge & Ball Bonder*", al fine di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca del Laboratorio di Acustoelettronica (ACULAB) della Sezione di Elettronica Applicata;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'acquisizione dei pareri favorevoli, ovvero dei necessari nulla osta espressi dai Direttori dell'Ateneo arch. A. Attanasio, dott. P. Cursi, ing. A. Masci, arch. L. Scacchi e dott. G. Colapietro, il Direttore della competente Direzione 9, dott. Ruben Rispoli, ha trasmesso la documentazione necessaria all'avvio della procedura;

**CONSIDERATO** che la documentazione trasmessa evidenzia che:

- l'intervento necessario riguarda l'acquisto di una Strumentazione per il *packaging* avanzato di dispositivi micromeccanici e microelettronici destinata al Laboratorio di Acustoelettronica della Sezione di Elettronica Applicata, finalizzato ad attività di ricerca nel campo dei sensori e microsistemi acustici e ultrasonici, svolte anche nell'ambito dei dispositivi e sistemi diagnostici medicali per ultrasuoni, come evidenziato nella relazione a firma del Responsabile scientifico del progetto, prof. Alessandro Neri;
- la strumentazione risultata meglio rispondente alle necessità evidenziate, per la specificità della fornitura e delle prestazioni richieste, è il Sistema "*Wire Bonder automatico HB100*" HB100 Automatic Wire Bonder" prodotto dall'azienda TPT Wire Bonder GmbH (Karlsfeld, Germania);
- il Dipartimento ha acquisito il preventivo (quotation n. 830 del 29.03.2021) formulato dalla Electron-Mec SRL, P. Iva e Codice fiscale 01773040157, distributore unico per l'Italia dei prodotti TPT Wire Bonder GmbH, che, per la fornitura richiesta, riporta l'importo di euro 97.594,58 oltre IVA di legge, ritenuto congruo e rispondente alle esigenze del Dipartimento;
- il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria ha autorizzato l'acquisto della strumentazione individuata al costo totale di euro 97.594,58 oltre IVA di legge, da imputare sui fondi dei progetti GE Parallel Design, GE Vingmed Ultrasound e STMicroelectronics, di cui il prof. Alessandro Neri è responsabile;

**VISTA** la nota prot. n. 67495 del 07.07.2022, a firma del Direttore del nuovo Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica, prof. Alessandro Neri, che evidenzia la rettifica dell'importo richiesto dall'operatore economico Electron-Mec SRL per la fornitura necessaria, come da preventivo aggiornato (Quotation n. 1884 del 13.06.20232), per un importo pari a euro 104.695,91 oltre IVA di legge;

**CONSIDERATA** che, unitamente alla predetta nota, il Dipartimento ha trasmesso:

- la dichiarazione di congruità della nuova offerta presentata Electron-Mec SRL per la fornitura della Strumentazione per il packaging avanzato di dispositivi micromeccanici e microelettronici "*HB100 Automatic Wedge & Ball Bonder*" prodotta da "*Tpt Wirebonder GmbH & Co*" al costo di euro 104.695,91 oltre iva di legge;

- l'indicazione dei fondi necessari: progetti: a) 816000-2018-AS-P.C.\_001 per euro 27.246,70; b) 816000-2020-AN-P.C.\_001 per euro 60.862,01 c) 816000-2020-AN-P.C.\_002 per euro 17.381,73; d) 816000-2020-AN-R.C.T.\_001 per euro 22.205,47;

- la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica nella seduta del 14 luglio 2022 che approva la variazione di spesa pari ad euro 7.101,33 oltre IVA di legge "valutata la disponibilità dei progetti GE Parallel Design, GE Vingmed Ultrasound e STMicronics, di cui il prof. Neri è responsabile";

**PRESO ATTO** che l'iniziativa non è presente nel "Programma biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a euro 40.000 ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016", approvato dall'Ateneo con Decreto rep. n. 328/2022;

**ACCERTATA** la sopravvenuta disponibilità di finanziamento all'interno del bilancio a seguito della stipula dei contratti GE Parallel Design, GE Vingmed Ultrasound e STMicronics di cui è responsabile scientifico il prof. Neri;

**CONSIDERATA**, quindi, la sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", di cui al Decreto Ministeriale del 16/01/2018, n. 14, che prevede che: "I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente ... qualora le modifiche riguardino: .... c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie ..";

**ACCERTATO** che, in relazione alla fornitura necessaria:

- non è attiva alcuna Convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. cui, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 228/2012 e s.m.i., è fatto obbligo alle Università di aderire;

- all'interno del Mercato Elettronico della P.A. gestito da Consip Spa (di seguito denominato "MePA"), cui le Università sono tenute a fare ricorso ai sensi della vigente normativa, è presente la Electron-Mec SRL, P. Iva 01773040157;

**VISTO** l'art. 1, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., secondo cui, in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30 giugno 2023, "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:..." a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50...;

**VISTO** il successivo comma 3 del citato art. 1, secondo cui "Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

**TENUTO CONTO** che, quindi, nel caso di specie, sussistono i presupposti normativi per procedere all'affidamento diretto della fornitura necessaria, attraverso l'avvio di una Trattativa diretta all'interno della piattaforma del MePA con la Electron-Mec SRL SRL, P. Iva e Codice fiscale 01773040157, sede legale in via Negroli, 51A, 20133 – Milano;

**ACCERTATO** dai competenti uffici che la disponibilità sul pertinente conto del bilancio per l'esercizio 2022 è congrua per accogliere il costo connesso all'esecuzione della fornitura in questione sui fondi dei progetti gestiti dal Dipartimento richiedente;

**DECRETA**

**Art. 1**

Per le finalità indicate in premessa ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e s.m.i., è disposto l'affidamento diretto della fornitura di un Sistema per il packaging avanzato di dispositivi micromeccanici e microelettronici "HB100 Automatic Wedge & Ball Bonder", prodotto dall'azienda TPT Wire Bonder GmbH, a favore della Electron-Mec SRL, P. Iva e Codice fiscale 01773040157, sede legale in via Negroli, 51A, 20133 – Milano.

La procedura si svolgerà attraverso l'avvio di una Trattativa diretta all'interno della piattaforma del MePA.

L'efficacia dell'affidamento è subordinata all'accertamento dell'assenza in capo all'operatore economico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

**Art. 2**

Il costo complessivo per la fornitura di cui all'articolo che precede, pari ad euro 104.695,91, al netto dell'IVA di legge, graverà sul conto A.A.01.01.02.03.01 "Macchinari e attrezzature scientifiche" del *budget* degli investimenti per l'esercizio 2022, progetti GE Parallel Design, GE Vingmed Ultrasound e STMicroelectronics.

**Art. 3**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel dott. Ruben Maria Rispoli, Direttore della Direzione 9 di questa Università.

**Art. 4**

È modificato, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, il "Programma biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a euro 40.000 ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016", approvato dall'Ateneo con Decreto rep. n. 328/2022.

Il presente decreto è reso esecutivo nei modi di legge e sarà acquisito al registro della raccolta interna

Il Direttore Generale  
dott. Pasquale Basilicata

VISTO

Il Direttore – Direzione 3  
dott. Giuseppe Colapietro